

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

639

ML4

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

20.01.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	μm		Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	720		2	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		3	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		4	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		5	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		6	
C-RS-FR4-DS-1.55mm-105+105-TG150-HF	50201125	105	L2	7	
		1340			
		105	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		8	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	720		9	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		10	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		11	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		12	
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	13	

Dicke nach Verpressen

B00:

3090 μm

Tol+:

320 μm

Tol-:

320 μm

Dmax:

3410 μm

Dmin:

2770 μm

Gesamtdicke über alles

0 μm

Tol+:

0 μm

Tol-:

0 μm

Dmax:

0 μm

Dmin:

0 μm

Kundenforderung

Dicke (D):

3200 μm

Tol+:

320 μm

Tol-:

320 μm

Dmax:

3520 μm

Dmin:

2880 μm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

3180 μm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik